

深圳回收芯片 C8051F350-GQR C8051F350 微控制器芯片

产品名称	深圳回收芯片 C8051F350-GQR C8051F350 微控制器芯片
公司名称	深圳市邵昕电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦
联系电话	0135-30101390 13530101390

产品详情

深圳回收芯片 C8051F350-GQR C8051F350

微控制器芯片, 深圳回收芯片, C8051F350-GQR, C8051F350, 微控制器芯片。

四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一, 引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看, 塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时, 多数情况为塑料QFP。塑料QFP是普及的多引脚LSI封装。不仅用于微处理器, 门阵列等数字逻辑LSI电路, 而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格。0.65mm中心距规格中多引脚数为304。日本将引脚中心距小于0.65mm的QFP称为QFP(FP)。但现在日本电子机械工业会对QFP的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别, 而是根据封装本体厚度分为QFP(2.0mm~3.6mm厚)、LQFP(1.4mm厚)和TQFP(1.0mm厚)三种。

另外, 有的LSI厂家把引脚中心距为0.5mm的QFP专门称为收缩型QFP或SQFP、VQFP。但有的厂家把引脚中心距为0.65mm及0.4mm的QFP也称为SQFP, 至使名称稍有一些混乱。QFP的缺点是, 当引脚中心距小于0.65mm时, 引脚容易弯曲。为了防止引脚变形, 现已出现了几种改进的QFP品种。如封装的四个角带有树脂缓冲垫的BQFP(见BQFP);带树脂保护环覆盖引脚前端的GQFP(见GQFP);在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专用夹具里就可进行测试的TPQFP(见TPQFP)。在逻辑LSI方面, 不少开发品和高可靠品都封装在多层陶瓷QFP里。引脚中心距小为0.4mm、引脚数多为348的产品也已问世。此外, 也有用玻璃密封的陶瓷QFP(见Gerquad)。